

Informations de base	
<p>2018/2947(DEA) DEA - Procédure d'acte délégué</p> <p>Exemption relative au plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée</p> <p>Complétant 2008/0240(COD)</p> <p>Subject</p> <p>3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique 3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)</p>	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur

Informations techniques	
Référence de la procédure	2018/2947(DEA)
Type de procédure	DEA - Procédure d'acte délégué
Sous-type de procédure	Examen d'un acte délégué
	Complétant 2008/0240(COD)
État de la procédure	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur
Dossier de la commission	ENVI/8/15029